

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-035

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 26 日以通讯会议方式在公司会议室召开第六届董事会第三次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司珠海宏昌签订〈合作框架协议书〉的议案》。

为了充分发挥企业间的各自优势，建立创新价值链，提升企业自主创新能力，实现双方利益最大化和社会效益最大化，本着资源共享、互惠互利、共同发展的原则，同意珠海宏昌电子材料有限公司与晶化科技股份有限公司在先进封装过程中集成电路载板之增层膜新材料（该增层膜新材料产品应用于半导体 FCBGA〈倒装芯片球栅格数组〉及 FCCSP〈倒装芯片级封装〉先进封装制程使用之载板中），或特定产品开展密切的研发及销售合作关系。同意珠海宏昌电子材料有限公司与晶化科技股份有限公司签订《合作框架协议书》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于子公司珠海宏昌签订〈技术开发（委托）合同〉的议案》。

同意珠海宏昌电子材料有限公司与晶化科技股份有限公司共同研究开发 FCBGA 载板使用之新型增层膜项目。同意珠海宏昌电子材料有限公司与晶化科技股份有限公司签订《技术开发（委托）合同》。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年6月27日